



LEXCM^{CF}

CV4180 CV4380

パワーモジュール用 高熱伝導封止材

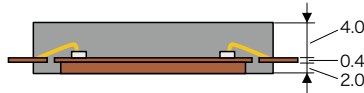
高実装性・高放熱性対応(パッケージ反りコントロール)、大型・ヒートスプレッタ露出パッケージ対応(低応力化による耐T/C性向上)、ニッケルメッキ対応(高密着化の実現)

用途

半導体パッケージ/オートモーティブ

車載用モジュール、白物家電・産業モーター用インバータモジュール

低応力化: 耐ヒートサイクル(T/C)性

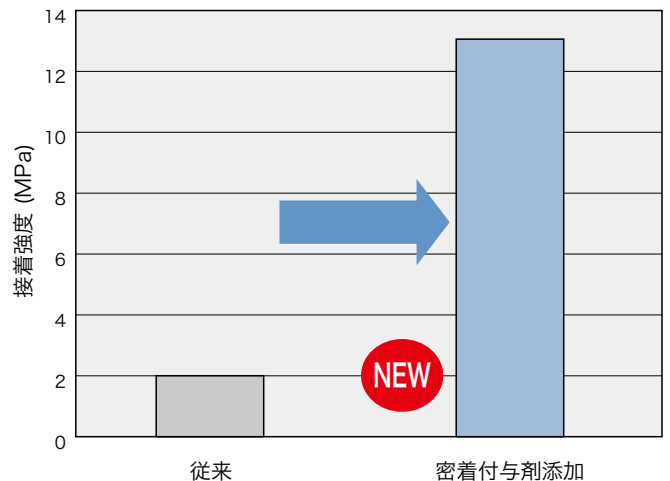
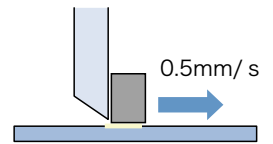
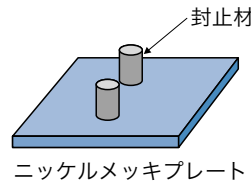


Mold size : 44x65x6.4mmt
Die size : 40x50x0.4mmt
Cu plate size : 36x46x2.0mmt

ヒートサイクル後のSAT観察 -50°C (30 min) ⇔ +150°C (30min)

	アフターキュア	100サイクル	300サイクル	500サイクル
Ref E=20GPa				
New E=14GPa				

ニッケルメッキ密着性: せん断密着力



上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

ラインアップ

品番	用途	特長
CV3300 / CV4380	フルモールドモジュール封止	高熱伝導グレード (1.7~2.3W/mK)
CV4500 / CV4580		超高熱伝導グレード (3.0~3.5W/mK)
CV4100A / CV4180A	ヒートスプレッタ露出タイプ モジュール封止	金属基板用 低応力タイプ
CV4100B / CV4180B		セラミック基板用 低応力タイプ

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry CV4180